

『ネプコンジャパン 2026』セミナー共同登壇のお知らせ

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社は、2026 年 01 月 21 日(水)より 01 月 23 日(金)まで開催される『ネプコンジャパン 2026』に出展し、同時開催されるセミナーにパートナー企業 Electroninks 社/サカティンクス社と登壇することとなりました。

展示会と同時開催となる、業界の発展を目的としたセミナーで、これまで培ってきた EMS（電子機器受託製造）としての知見にとどまらず、材料技術との融合による新たな価値創出への取り組みを紹介します。

講演日時： 1 月 23 日(金) 14:00 - 14:30

タイトル： SIIX セミナー：EMS×材料で切り拓く次世代バリューチェーン

講演 1： 【先端パッケージ材料の車載応用：MOD インクが変える次世代 EMI シールド技術】

内 容： 導電性金属錯体(MOD)インクによる電磁波シールドとしての応用例ご紹介

講演者： ELECTRONINKS INC. HEAD OF ASIA BUSINESS 望月 卓 氏

講演 2： 【材料メーカーとの共創による市場創出と収益最大化】


内 容： 複数の材料を混合させたハイブリッド新付加価値提案ご紹介

講演者： サカティンクス株式会社 研究開発本部 開発企画部長 野田 浩章 氏


SIIX セミナー： EMS×材料で切り拓く次世代バリューチェーン

1 月 23 日 金曜日 14:00 - 14:30 新製品・新技術セミナー〜New Tech Trend〜会場①

シークス側は、これまで培ってきたEMS（電子機器受託製造）としての知見にとどまらず、材料技術との融合による新たな価値創出に取り組んでいます。製造プロセスの最適化やコスト競争力の追求に加え、材料メーカーとの共創を通じて、設計・材料・実装を横断した次世代バリューチェーンの構築を目指しています。本...



望月卓, エレクトロニクス, ア
ジア・ビジネス, ヘッド



野田浩章, サカティンクス (株),
研究開発本部 開発企画部, 部長

ご多忙のところ誠に恐縮ですが、弊社出展ブースと併せてお立ち寄りいただけますと大変幸いです。

記

展示会名：ネプコンジャパン 2026 (<https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp.html#/>)

開催日時：2026 年 01 月 21 日(水)～01 月 23 日(金) 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト（アクセスはこちら：<https://www.bigsight.jp/visitor/access/>）

弊社ブース番号：E7-12

出展内容：EMS 事業能力紹介 / Electroninks 紹介 / Innominds 紹介

入場方法：事前登録 (<https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1523277294327642-H1N>)

お問い合わせ：シークス株式会社 営業企画室（代表メール：eigyokikakushitsu@siix-global.com）

展示会担当者：坂本/川田（電話：03-6773-7909 メール：takuma.kawada@siix-global.com）

以上